

# 나노코리아 2024 산업화세션 개요

## □ 세션 개요

- 행사명 : 나노코리아 2024 산업화세션
- 일 시 : 2024년 7월 4일(목) 13:00~16:50
- 장 소 : KINTEX 제1전시장 강연장A
- 주 제 : 차세대 반도체/디스플레이 산업 초격차 달성을 위한 나노융합기술
- 등록비용 : (일반) 150,000원 / (학생) 50,000원

## □ 세부 프로그램

시간	주제	구분	발표주제	연사
1부 좌장 : 최경호 탄소나노PD (한국산업기술기획평가원)				
(1부) 반도체 첨단 패키징				
12:50~13:00	개회사 : 전시위원장, 심포지엄위원장			
13:00~13:30	반도체	수요	Technology and Future of Semiconductor Packaging Materials	문기일 부사장 (SK하이닉스)
13:30~14:00			Advanced Packaging Technology for AI Era	강운병 마스터 (삼성전자)
14:00~14:20		공급	The advanced packaging technology in AI era ; Chiplet and Integatation	김종헌 부사장 (네패스)
14:20~14:40			차세대 전력반도체 패키징용 200W/mK급 무가압형 칩본딩재 기술	김윤진 대표 (테라온)
14:40~15:00			반도체 접합용 무세척 에폭시 소재	문종태 대표 (호전에이블)
15:00~15:10	BREAK TIME			
2부 좌장 : 최경호 탄소나노PD (한국산업기술기획평가원)				
(2부) 차세대 디스플레이와 나노				
15:10~15:40	디스플레이	수요	The Best Display Solution for SDV	손기환 상무 (LG디스플레이)
15:40~16:10			Challenge for next era of display	허종무 상무 (삼성디스플레이)
16:10~16:30		공급	Perovskite Emitters for Next-Generation Displays	이태우 교수 (서울대학교)
16:30~16:50			융복합 폼팩터 디스플레이를 위한 고신뢰성 플렉시블 모듈 기술	정용철 수석연구원 (한국생산기술연구원)